

证券代码：688589

证券简称：力合微

债券代码：118036

债券简称：力合转债

深圳市力合微电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-012

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他		<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	长信基金	肖文劲	
	宁涌富基金	韩洲枫	
	中银国际证券	叶志成	
	天风证券	李浩时	
会议时间	2024年8月7日		
会议地点	公司会议室		
公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：夏滨 董办主任、证券事务代表：龚文静		

投资者关系活动主要内容介绍：

一、介绍公司的基本情况和最新经营情况：

公司作为一家芯片设计企业，专注于物联网通信和连接 SoC 芯片，在电力线通信（PLC）、电力线+无线多模通信等拥有自主可控核心技术及系列芯片，并不断加大研发投入、坚持创新、拓展市场应用，为物联网（IoT）、智能家居、光伏新能源等各种数字化、智能化应用场景提供“最后一公里”通信、连接芯片及芯片级完整解决方案，以物联网、新能源、双碳经济、智能家居、数字化

转型和智能化升级为市场驱动、以发展自主芯片技术和硬核科技为宗旨，不断提升企业品牌和发展成为该领域芯片领军企业。2023年，公司实现营业收入57,918.82万元，较上年同期增长14.96%；实现归属于母公司所有者的净利润10,688.66万元，较上年同期增长42.26%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润9,278.91万元，较上年同期增长73.30%。

2024年第一季度，公司实现营业收入12,986.14万元，同比增长17.09%；实现归属于上市公司股东的净利润2,335.65万元，同比增长9.5%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,126.14万元，同比增长5.54%。

二、解答投资者提问，主要提问及解答如下：

1.在智能家居领域，PLC技术用于二手房全屋智能改造，会不会存在需要重新布线等问题？

答：PLC技术在智能家居领域的应用，既可以通过在家用电器设备中内置PLC芯片，并在网关上植入芯片来实现通信，也可以采用在适配器/变压器或插座、接线板等设备上内置PLC芯片的解决方案。PLC通过已有电线进行数据传输，无需重新布线，具有穿墙越壁，信号不受阻挡的优势，能够有效实现智能家电的内部控制与通信连接。

2.目前除了华为、力合微等公司对PLC智能家居应用的大力推动，还有哪些品牌正在布局PLC智能家居？

答：PLC（电力线通信）技术通过华为、力合微等企业在智能家电&全屋智能领域、智能照明等物联网应用市场大力推动下，已经与WiFi、ZigBee、Bluetooth等射频无线通信技术共同成为物联网“最后一公里”连接的主流通信技术之一。

在消费类行业应用上，公司持续打造PLBUS PLC技术品牌，以“无需布线、有电即通信、低延迟、高可靠性”等特点，经过多年技术营销、品牌营销市场推广，已获得众多知名企业认可，推动了PLBUS电力线载波通信芯片在智能家居应用领域的批量应用，并助力构建开放的智能家居生态。华为全屋智能AO.SMITH AI-LINK均采用以PLC技术为主的全屋智能设备互联的通信技术，其他企业生态系统也在加速导入PLC。近期天猫精灵推出的全屋智能产品方案

就是采用了 PLC 技术、由小米发起的全屋互联开放联盟（HCOA）也在积极推动有线 PLC 技术标准的统一，以 PLC 通信技术为家居全屋智能的主要连接技术态势正在形成。

3.在智能电网市场，公司芯片在低压配网创新应用是否属于新的增长点？

答：公司在既有市场的基础上，拓宽应用领域，顺应电网公司智能化、数字化发展的政策，在电力设备万物互联的大趋势下，积极开发应用于低压配网市场的新产品，用于低压配网创新应用的通信单元、量测单元和中继器等新产品已实现了批量供货。随着国家电网对电网智能化及配网自动化的进一步改造需要更多的终端设备增加远程控制及通信功能，比如智能断路器、智能开关等等，相较于原来只是智能电表的控制，未来通过电力线技术来连接的节点会更广泛，智能电网领域的市场总量将大幅提升。

4.公司芯片产品的存货压力怎么样？

答：公司不断加强供应链体系的管理，加快存货周转，2023 年公司基于自研芯片及核心技术的产品库存量较上年减少了 49.62%，存货压力较小；公司芯片产品均为自主设计开发，在晶圆厂的选择上有较大的自主权，无论在价格、交货期、增量需求等各个方面都展现出了较强的竞争优势；此外，公司通过及时了解市场供应状况，及时向芯片合作厂商提供预计订量，提前预留产能，有效地保证了公司芯片的供应，能够满足市场的需求。

5.公司今年考虑下修转股价格吗？

答：公司于 2024 年 2 月 26 日召开了第四届董事会第八次（临时）会议，董事会决定自 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 8 月 26 日期间不向下修正“力合转债”的转股价格。若再次触发“力合转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否向下修正“力合转债”的转股价格。